

## 車載MOSFET DSOP Advance(WF)シリーズ

DSOP Advance (Wettable Flank) family for Automotive MOSFETs

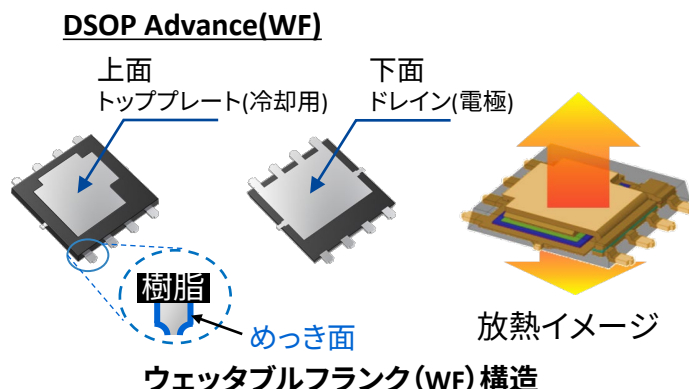
### 小型、高放熱パッケージでECUの小型化に貢献

Point

1

#### パッケージ両面からの放熱構造の採用により高放熱性を実現

- 上面に冷却用トッププレートを設け、パッケージ両面からの放熱が可能、ECUの発熱を抑え、小型化に貢献。
- 自動光学検査に対応可能なウェットフラंक(WF)構造を採用。



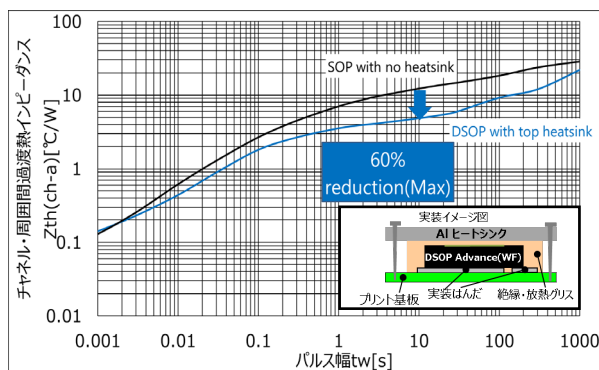
Point

2

#### 同サイズの製品に対して最大60%、熱抵抗性能を改善

- 従来製品(SOP Advance)※に対して高い放熱性を発揮。

※当社製品比



Point

3

#### モーター駆動回路部への採用実績あり

- 電動パワーステアリングシステム(EPS)を中心とした様々なモータの駆動回路部に採用。
- 優れた放熱性と低オン抵抗による導通損失の低減で、セットの小型化に貢献。

